

# M-VIA Flex® FR4-Flex基板

## Semiflex PWB

### 特長 Features

- FR-4.0, 4.1のプリント配線板材料で屈曲できる基板  
Bendable PWB with FR-4.0, 4.1 Material

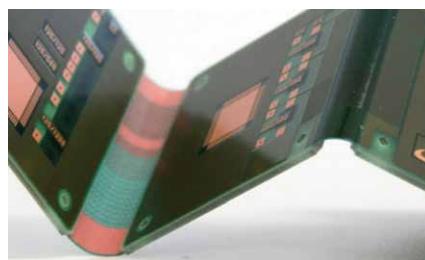
#### コンセプト Concept

フレックスリジッド基板より簡素プロセス  
Simpler Process than Flex-Rigid

同一接続(コネクタレス)  
Single Board Connection (Connector Less)

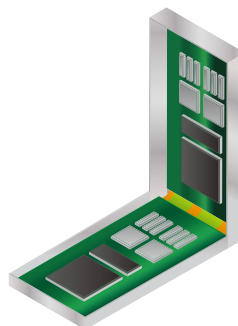
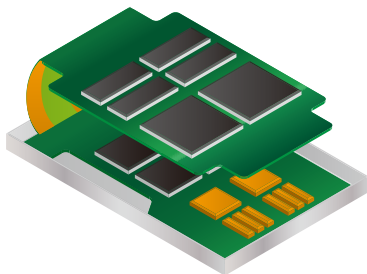
ポリイミド材レス通常PWB材料  
Ordinary PWB Material (PI less)

### 基板屈曲例 Examples of Bendable PWB



### メリット Merit

- 工程簡素化による低コスト化のみでなく、コネクタレスによる小型化・省スペース化への貢献  
Contribution to cost reduction through process simplification and to miniaturization and space saving through connector-less design



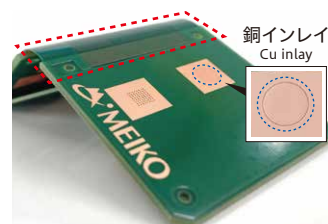
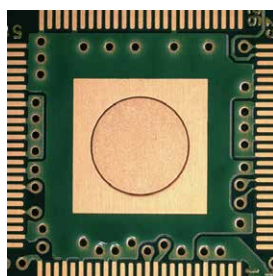
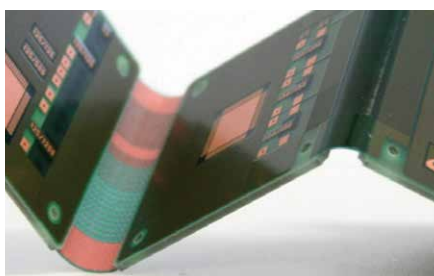
### 用途 Applications

- 車載向け:EPS、ECU、カーナビ
- 民生向け:SSD、照明器具、医療機器 等

### 更なるソリューション Further Solutions

R&D

- M-VIA Flex® FR4-Flex+銅インレイにより小型化・3D実装に放熱機能を追加  
M-VIA Flex® FR4-Flex + Cu inlay adds heat dissipation to miniaturization and 3D mounting



銅インレイ基板と組合せ構造  
Structure for Cu inlay and FR4-Flex